



DRAMモジュールのアドオンオプション： 過酷な環境でも安定して保護

DRAMモジュールは過酷な環境での普及が進んでおり、自動化、航空宇宙、海運、その他厳しい条件が課せられる産業で頻繁に見られる、高温、振動、汚染、化学薬品などに晒されます。長期間を経て、電子機器の深刻な破損や、腐食やショートなどが発生する可能性があるため、こうした環境では保護機能の強化に対する要求が高まっています。

Innodiskは、産業メモリーソリューションの世界的な大手プロバイダーです。高品質なDRAMモジュールに加え、コンフォーマルコーティング、サイドフィル技術、ヒートスプレッダー、堅牢クリップなど、高信頼性のアドオン機能を用意しており、顧客のアプリケーションが安定してパフォーマンスを発揮できるようにします。

コンフォーマルコーティング

コンフォーマルコーティングは、DRAMモジュールを湿気、汚染物質、塵、酸またはアルカリ物質などの破損から保護します。モジュールへアクリルとシリコンの薄い絶縁層を加えることで、汚染からモジュールを保護し、製品寿命を延ばします。当社のコンフォーマルコーティングは、HumiSealが供給する最高級の素材を使用し、信頼性と品質を保ってIPC-A-610検査規格を満たしています。

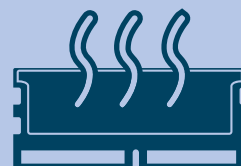


サイドフィル技術

強い衝撃が加えられたり極端な温度変化に晒される環境でも、プリント基板 (PCB) とBGA間の接合を強化し、信頼性を増して、製品寿命を延ばします。DRAM ICの3辺へ樹脂を塗布することで、BGAとPCBの接合を強化しています。引張試験では、サイドフィルを適用すればモジュールは最大2倍の引張応力に耐えられることが確認されています

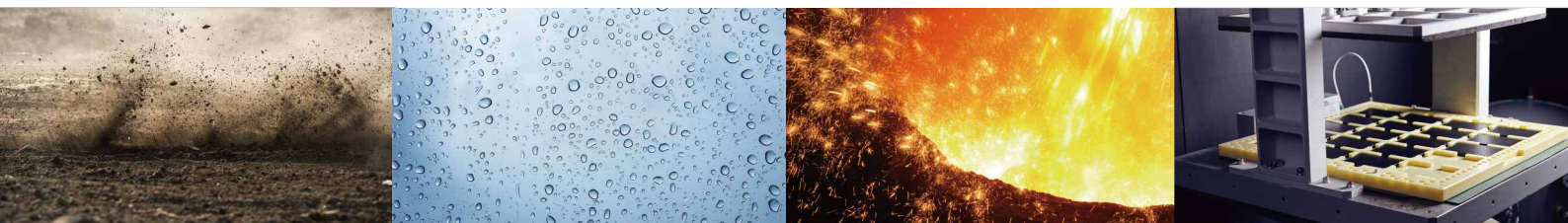
ヒートスプレッダー

BGA ICが小型化し、熱を発生しやすくなっているため、熱転送用にヒートスプレッダーを設計しました。優れた熱拡散性と熱伝導性を持つヒートスプレッダーは、DRAMモジュールが適切な温度範囲で動作するようにし、モジュールの温度を約5°C下げてパッシブ放熱の効果を高めます。アルミニウムとカーボンナノチューブの2種類の素材を選択でき、どちらも放熱速度と効率を改善します。



堅牢クリップ

堅牢クリップは強い揺れや連続した振動、突発的な動きの際、DRAMモジュールがPCBのソケットから落ちる危険を無くす、非常に信頼性の高い機能です。マザーボードの設計を変更せずに、メモリーをスロット内へ固定できます。当社の堅牢クリップは顧客の多彩な要件すべてを満たし、EIA 364-28 VIIに基づく振動試験に合格しています。



本社所在地

Innodisk Corporation
5F., No. 237, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
TEL : +886-2-7703-3000 FAX : +886-2-7703-3555
E-mail : sales@innodisk.com